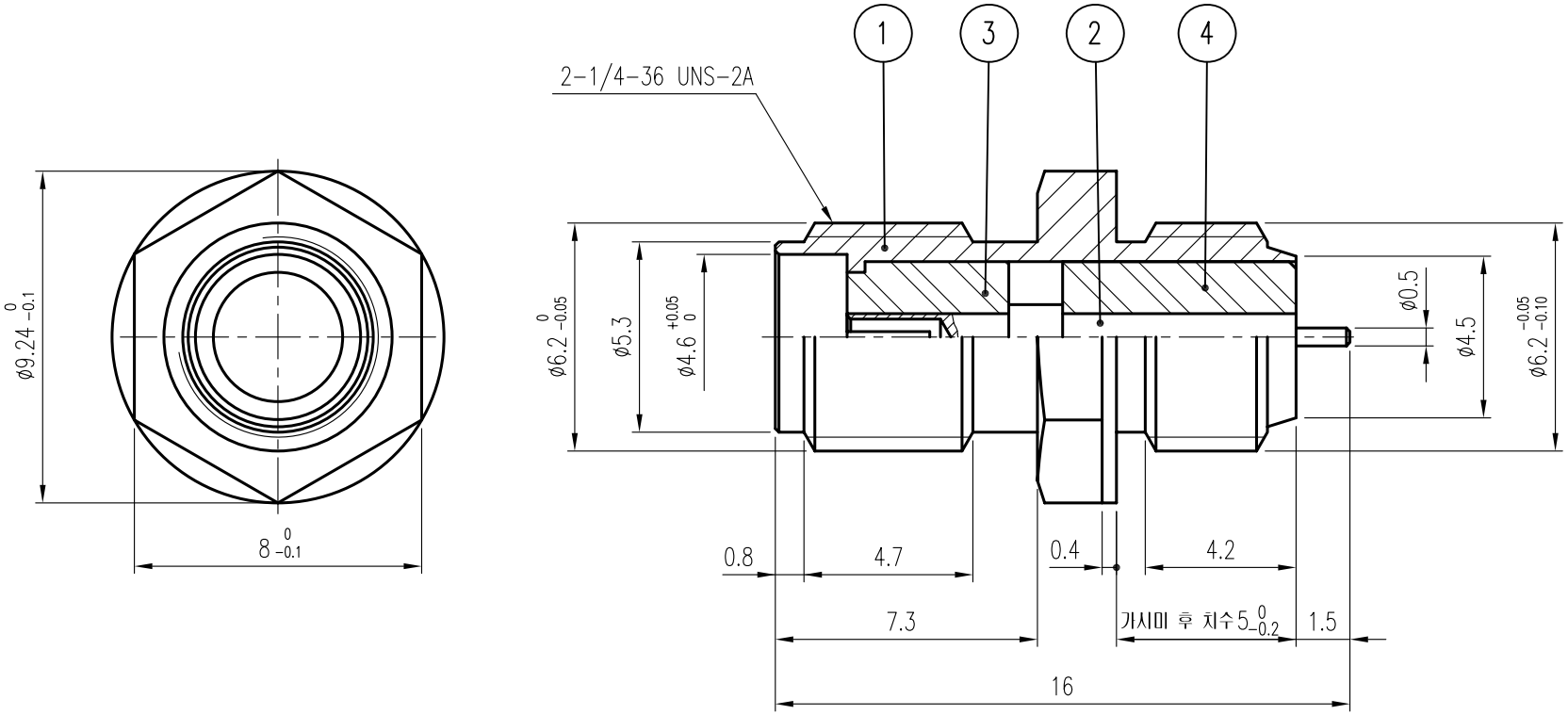
가공 / ST									
ST(기존)									
ST(개선)									

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00135-N/1 (H2229)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00207-N/1 (H2101)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00185-1345/1 (E2333)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00318-135/1 (D2300)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2002. 7. 19.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 5/1 단위 mm 중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명
SMA50 SOLDER END JB (F/F)

A4

도번 CN00114-7/1

K314-518-000